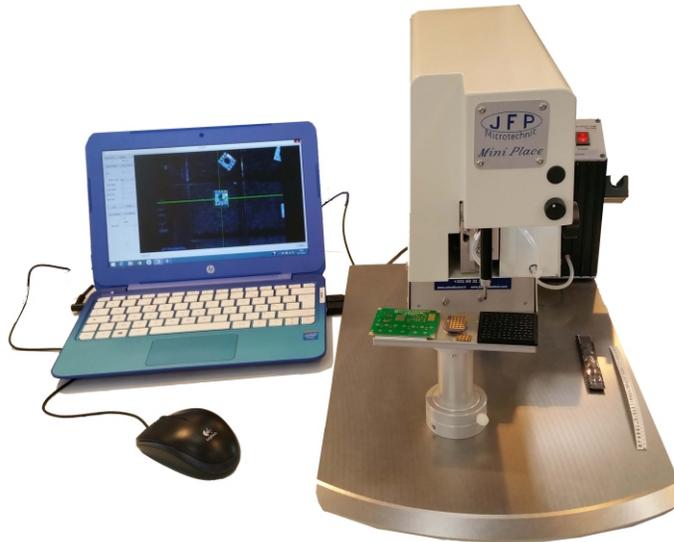


MPS Mini-Bestücksystem mit motorsiertem Z und Y Arm



MINI-PLACE SYSTEM

Zum präzisen Platzieren von Chips und Mikrokomponenten (DIE & SMD Parts Assembly)

- Kompaktes Tischgerät
- Manueller oder motorisierter Z und Y Arm
- Echte vertikale Bewegung
- Vakuumhalterung
- Zykluszeit 3 sec

Einsatzgebiete

Das Minibestücksystem MPS ermöglicht das äusserst präzises Pick & Place von winzigen IC Komponenten. Eine justierbare Optik mit Zoom-Modifikation ermöglicht das Bearbeiten von verschiedenen Chip Größen.

Anwendungen

- > Exoxy Dispensen
- > Solder Paste für SMD
- > SMD Reflow
- > Eutectic die bonding

Optische Kontrolle

- > Inspektions-Kamerasystem
- > Notebook
- > Digitales Fadenkreuz, justierbar
- > Ringleuchte mit LED

Die und Substrat

- > Kleinste Chipgröße: 200x200µm
- > Bildausschnitt horizontal: 1-6 mm/5-15 mm
- > Substratgröße bis zu 350 mm
- > Wafflepack, Gelpack

Work Holder

- > Manuell bedienbar
- > Arbeitshöhe: 100 mm, justierbar
- > Arbeitsbereich 200 x 200 mm
- > Micrometer und X Y-Tisch
- > Winkelpositionierung durch Drehung
- > Beheizte Work Holder 50 mm Durchmesser

Sonstiges

- > minimalstes Aufnahmegewicht <10g
- > langsames Absenken des Aufnahmetools
- > Hot Gas für SDM Reflow

MPS Mini-Bestücksystem

Einsatzgebiete:

Pick & Place von sehr kleinen Chips und auch größeren Bauteilen, wie z.B.

IC, BGA, MEMS, Sensors, SMD, resistor chips

Optional:

Video MicroPlace Interface'

Dispenseraufsatz für 3 cc Kartuschenhalter

Dispenser Reglereinheit

Epoxy Stamp tool holder

Pick-Place Stamp in 3 Stufen

Vacuum Chuck 50mm GelPack/Waffle Pack

Vacuum Chuck 50mm Mikrometer

Digitale Bondkraftmessung

Mikrometrischer X Y - Tisch und Theta

Olympus Kamera mit Zoom

Motorisierte Z-Achse

Technische Daten:

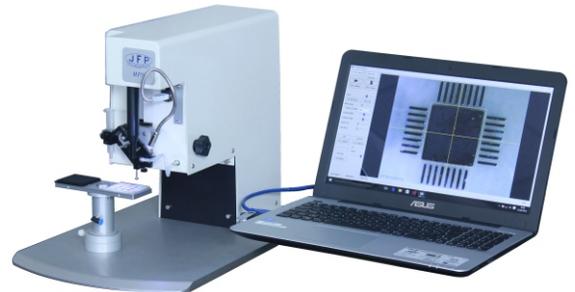
Spannung: 100-230 VAC 300W

Druckluft: 5 bar

Vakuum: 90 %

Abmessung: 580 x 510 x 490 mm

Gewicht: 45 kg



MPS Mini-Bestücksystem

Applikationen, Zubehör und Optionen

1. **Pick & Place und Dispenser Applikation in einem Werkzeug**
 - > Pick up Werkzeug, Die-Aufnahme
 - > Standard 1/8" (3,13 mm)
 - > Cartridge-Halter
2. **Dispenser Kontrolleinheit**
 - > Einstellung von Druck und Zeit
 - > Digitale Zeit
 - > manuelles oder haltautomatisches dispensen
 - > Steuerung mittels Fuss-Schalter
3. **Epoxy Stamping Distribution**
 - > Stamping Werkzeughalter für 1/8 stamping tool (3,17mm)
 - > Pick and Place stamp in 3 Stufen
 - > höhenjustierbar
 - > Pick 2", Waffle-Gel Pack
 - > Substrathalter mit Befestigungsklammer
 - > Epoxy Verteilung für stamp: drehbare Scheibe/manuelle Rotation, justierbare Dicke des Epoxy
4. **Vakuum-chuck 50mm GelPack/Waffle Pack**
 - > justierbare Höheneinstellung
 - > kompatibel für Waffle pack 2"
 - > Teile werden mit Vakuum gehalten
5. **Vakuum-chuck 50mm, Mikrometer**
 - > justierbare Höheneinstellung
 - > kompatibel für 2 Waffle pack holders (2"x2")
 - > 1 Mini Vakuum chuck 1"
6. **Digitale Kraftmessung, 0-500 gr, Kit**
 - > Werkzeug um niedrige Bondkräfte zu messen
 - > incl. höhenjustierbarer Halterung
7. **Mikrometrische Ansteuerung in X-, Y und Theta**
 - > X&Y mikrometrische Feinjustierung
 - > Mikrometerauflösung: 1 µm
 - > Feinjustierung in der Mitte
8. **Beheizte Chucks**
 - > 50mm Durchmesser, 48V, max. 400 °C
 - > externer Temperaturregler
 - > Heiztool 200 °C
9. **Video HD Kamera 5M/Video MicroPlace Interface**
10. **Vakuum-Stift**



1. Pick and Place



5. Vakuum Chuck / Heiztisch



6. digitale Kraftmessung



7. Mikrometerschrauben